



平成 22 年 9 月 3 日

各 位

会社名 株式会社 S U M C O
代表者名 取締役社長 田口 洋一
(コード番号 3436 東証第一部)
問合せ先 広報・I R 室長 澁谷 博史
(T E L. 03-5444-3915)

当期第 2 四半期連結累計期間の予想値と決算値との差異に関するお知らせ

平成 22 年 3 月 12 日に公表しました平成 23 年 1 月期第 2 四半期連結累計期間の業績予想値と本日公表しました当該連結累計期間の実績値に差異が生じたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 平成 23 年 1 月期第 2 四半期連結累計期間の業績予想数値と実績値との差異 (平成 22 年 2 月 1 日～平成 22 年 7 月 31 日)

	売 上 高	営業利益	経常利益	四半期 純利益	1 株当たり 四半期純利益
前回発表予想 (A) (平成 22 年 3 月 12 日公表)	百万円 125,000	百万円 △14,000	百万円 △24,000	百万円 △20,000	円 銭 △77.59
第 2 四半期連結累計期間 実績 (B)	142,337	△1,124	△9,909	△8,394	△32.57
増 減 額 (B-A)	17,337	12,876	14,091	11,606	—
増 減 率 (%)	13.9%	—	—	—	—
(ご参考) 前期 (平成 22 年 1 月期第 2 四半期) 実績	95,777	△48,832	△61,201	△52,921	△205.32

2. 差異の理由

当期第 2 四半期連結累計期間の売上高につきましては、半導体用シリコンウェーハの需要が 3 月時点の想定を超える水準で増加してきたため、前回予想値を上回りました。

損益に関しましても、売上高の増加に伴い、前回予想値から改善いたしました。

以 上